

<<半导体光电器件封装工艺>>

图书基本信息

书名：<<半导体光电器件封装工艺>>

13位ISBN编号：9787121128875

10位ISBN编号：712112887X

出版时间：2011-6

出版时间：电子工业

作者：陈振源

页数：95

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<半导体光电器件封装工艺>>

### 内容概要

本书(陈振源任总主编)针对整个半导体光电器件封装所用条件及工艺流程进行介绍,包括:光电器件封装规范、扩晶工艺、装架工艺、引线焊接工艺、器件封装工艺、产品的检测与包装6个项目,对半导体光电器件封装工艺流程及技术要求都做了说明,内容浅显易懂,注重实际操作工艺及理论联系实际的能力。

本书适合中等职业学校光电相关专业的学生使用,也可以作为光电器件封装技术工人的培训教材。

为了方便教师教学,本书还配有部分技能训练实际操作的教学光盘,供教学使用。

## <<半导体光电器件封装工艺>>

### 书籍目录

#### 项目一 光电器件封装规范

##### 任务一 了解光电器件的封装工艺环境

###### 一、光电器件的封装

###### 二、光电器件封装工艺环境

###### 复习思考

##### 任务二 光电器件封装安全性的认识

##### 任务三 光电器件封装过程中的安全防护

###### 一、封装安全防护之防静电规程

###### 技能训练一 静电防护装备及设备识别与配备（见光盘）

###### 二、封装安全防护之操作人员规程

###### 复习思考

##### 项目小结

#### 项目二 扩晶工艺

##### 任务一 识别芯片信息

###### 一、芯片的信息

###### 二、芯片的存储

###### 复习思考题

##### 任务二 扩晶工艺

###### 一、扩晶的目的

###### 二、扩晶设备

###### 三、扩晶工艺过程

###### 四、扩晶技术要求及注意事项

###### 技能训练二 扩晶工艺实操（见光盘）

###### 复习思考题

##### 任务三 芯片的镜检

###### 一、芯片的分选技术

###### 二、芯片的镜检

.....

#### 项目三 装架工艺

#### 项目四 引线焊接工艺

#### 项目五 器件封装工艺

#### 项目六 产品的检测与包装

#### 附录A 5S企业管理规范

#### 附录B 光电行业常用长度单位的换算

#### 附录C 本书配套最简单实训室配置

#### 参考文献

<<半导体光电器件封装工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>